

DATE: April 2026

INTENT: Executive Strategic Briefing

TERMINAL: Active

DISTRIBUTION: Confidential

# Semiconductor Value Chain Digest: The 2026 Paradigm

記録的な利益、次世代アーキテクチャ、そして再編される覇権の行方

# 業界を揺るがす3つのシグナル (April 24-30, 2026)



8x

## 営業利益の爆発的増加

- Q1営業利益が¥57.2T（前年比約8倍）
- 利益の94%を半導体部門が牽引
- ハイパースケラーの長期契約によりHBMは2027年まで深刻な供給不足へ



+13%

## AIネイティブ・スマートフォンの幕開け

- OpenAIが次世代デバイスの主要サプライヤーにQualcommを指名
- MediaTek, Luxshareと連携し2028年量産へ
- 報道を受け株価が急騰



55 yrs

## 過去55年で最高の月間パフォーマンス

- Intel株が4月だけで2倍以上に高騰
- 18A / 14Aノードの歩留まり大幅改善
- \$14.2Bによるアイルランド工場株の買い戻し完了

# Next-Gen AI Compute Stack: 3つの異なるアプローチ

	<b>NVIDIA (Vera Rubin)</b>	<b>AMD (MI400 / Helios)</b>	<b>Apple (M5 Family)</b>
Focus	データセンター向け超高性能・フルスタック	ラックレベルAIエグザフリップス	消費電力重視・エッジAI (M5 Pro / Max)
Architecture	Vera CPU + NVLink-6 + Groq 3 LPU	TSMC N2 + CDNA 5 (MI455X)	TSMC N3E / 初のチップレット設計
Key Specs	336B Transistors / 50 PFLOPS / 288GB HBM4	Helios Rack: 72× MI455X / 31TB HBM4 / 1.4 PB/s	10-core M5 (27,422 CPU Mark) / 競合を凌駕
Timeline	H2 2026 量産開始	H2 2026 計画通り進行中	April 2026 MacBook Proへ搭載開始

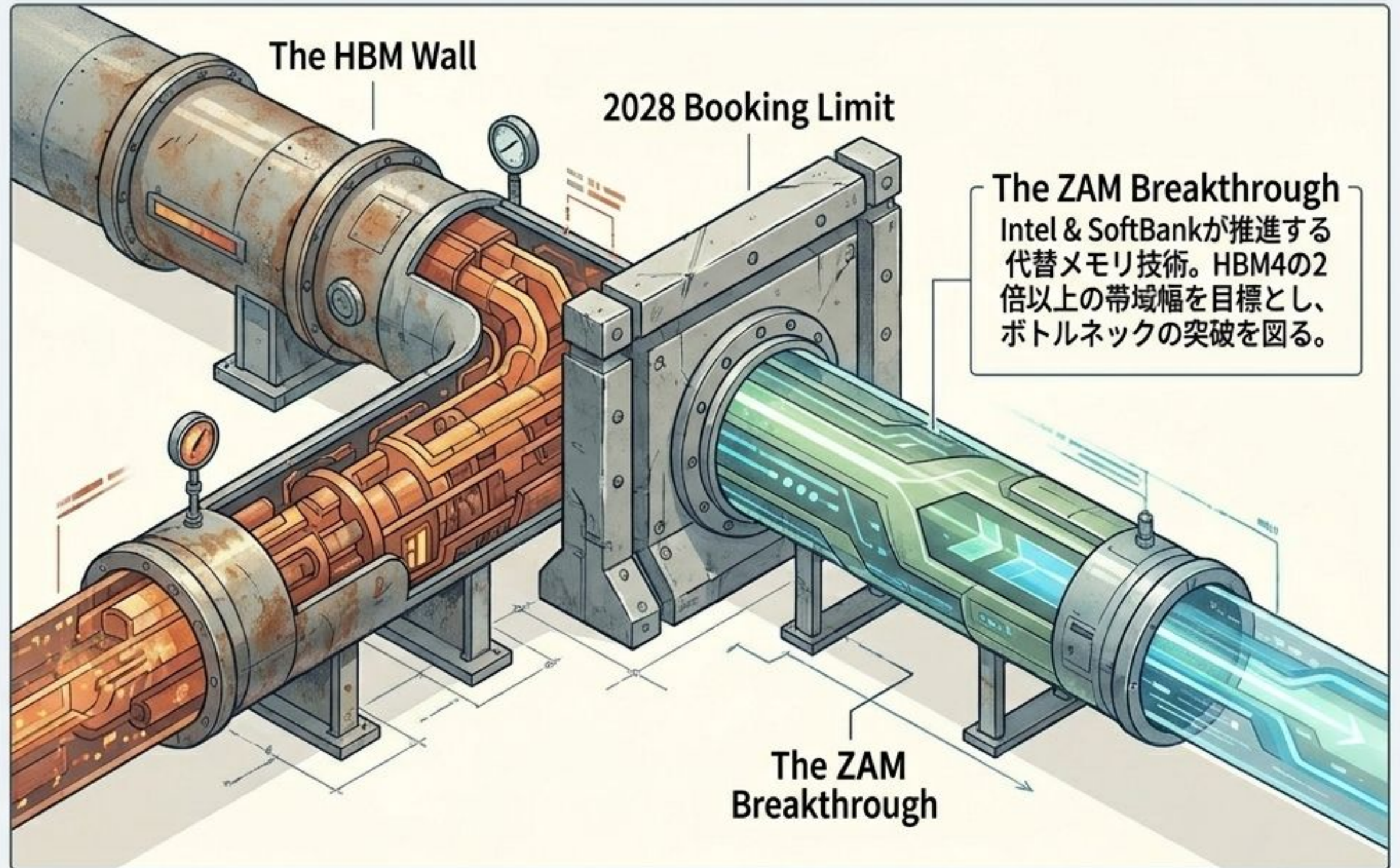
# The Memory Bottleneck: HBMの枯渇と次世代へのバイパス

**72%  
Margin**

SK hynix Q1営業利益率  
(利益は前年比+405%)

**3+  
Years**

HBMの予約状況。ハイパー  
スケーラーにより2028年ま  
で供給枠が完売。



# The Foundry Wars Matrix: 製造覇権を巡る三つ巴



**TSMC**  
(The Leader)

2nm Yield

**60-70% (優位)**

Next Node: A16 / N2P (H2 2026) -> A13 / N2U (2029)

Strategic Moves

AI比率が収益の約1/3に到達。  
Intelを「強力な競合」と言及。



**Samsung**  
(The Challenger)

2nm Yield

**~55% (TSMCと約10ptのギャップ)**

Next Node: ASMLへEUV含む製造装置の大量発注を継続

Strategic Moves

Intelとの「共同ファウンドリ」構想の噂。打倒TSMCへ向けた協調の可能性。



**Intel**  
(The Turnaround)

2nm Yield

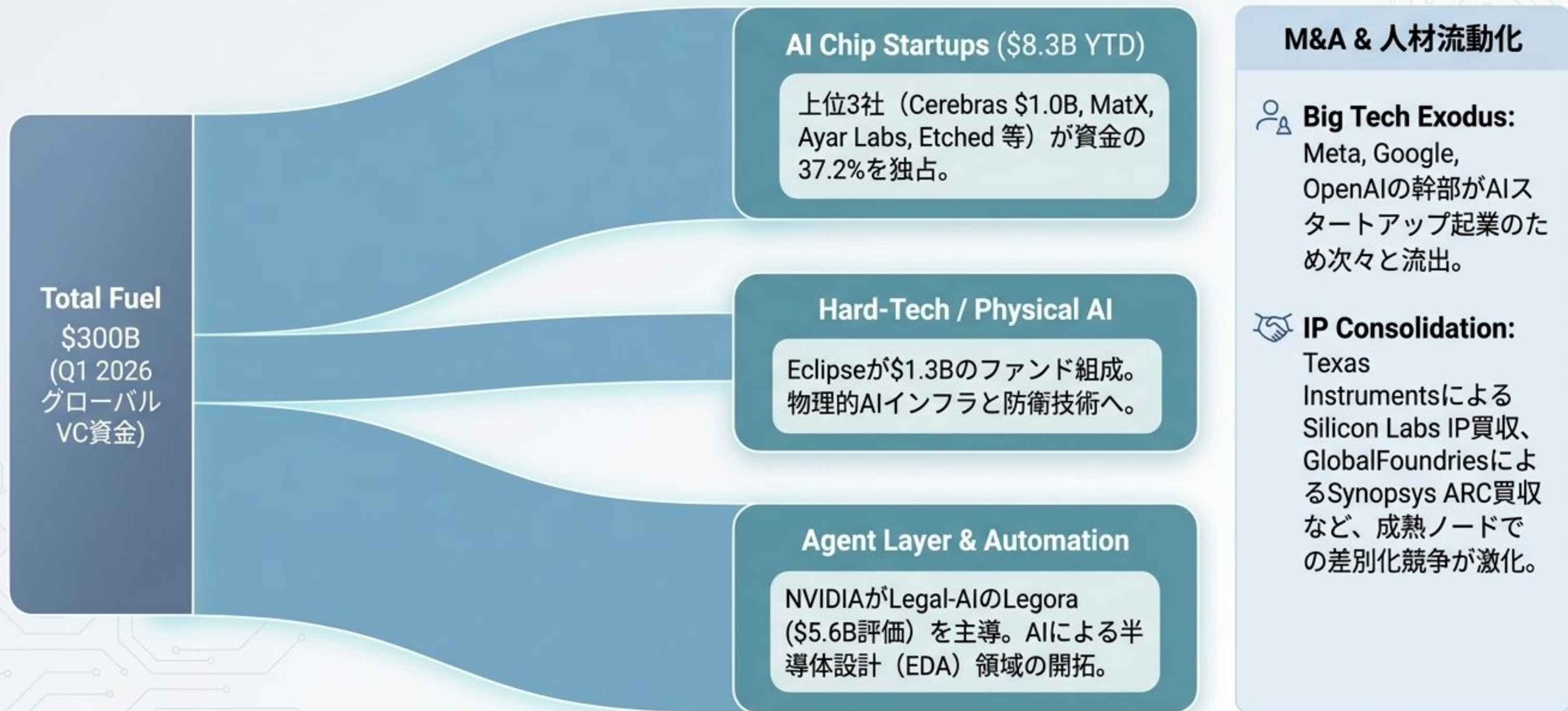
**詳細不明 (18A/14Aの歩留まりは大幅改善)**

Next Node: 18A / 14Aの軌道修正と量産体制の構築

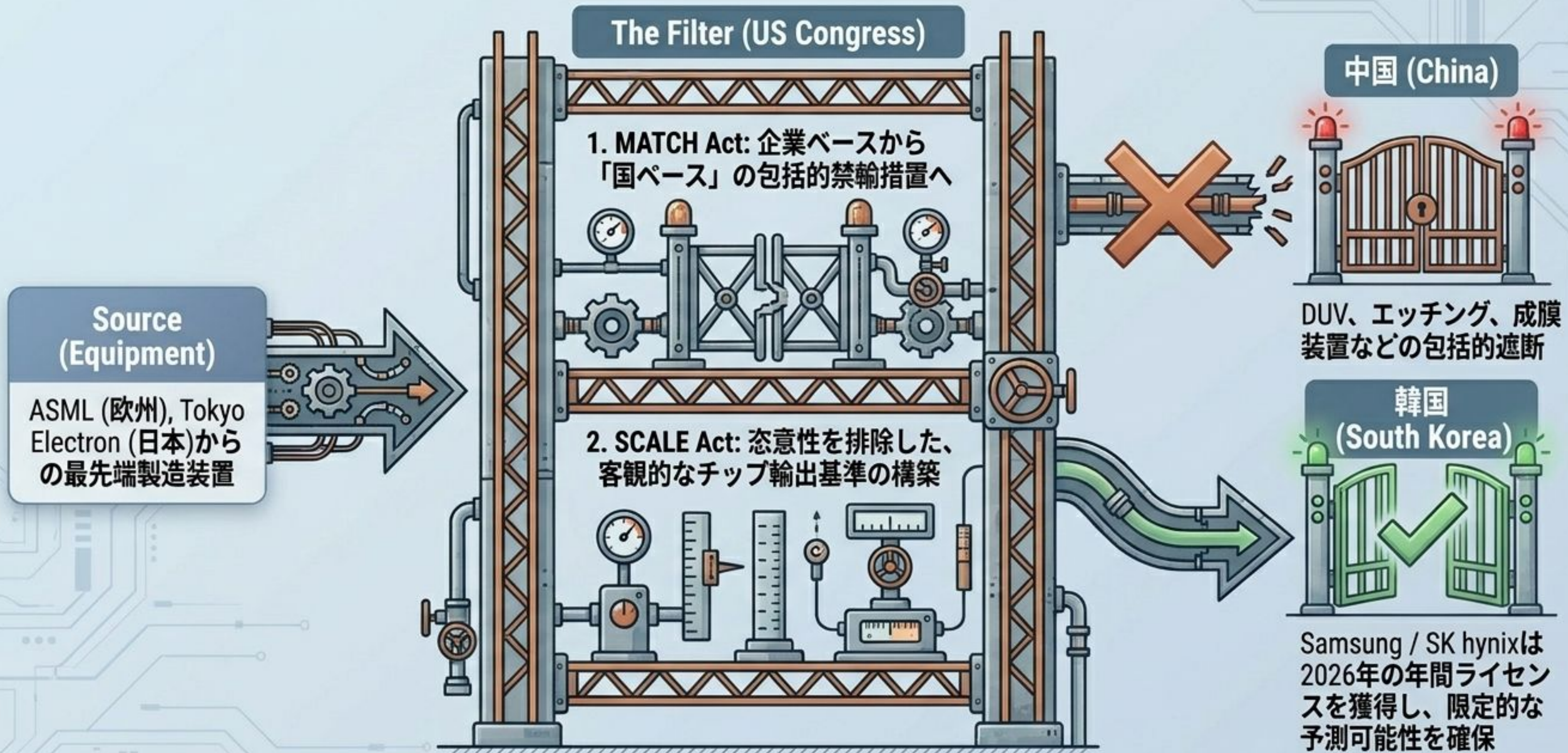
Strategic Moves

\$14.2Bでアイルランド工場の支配権回復。Samsung出身幹部を招聘しアジア顧客を狙う。

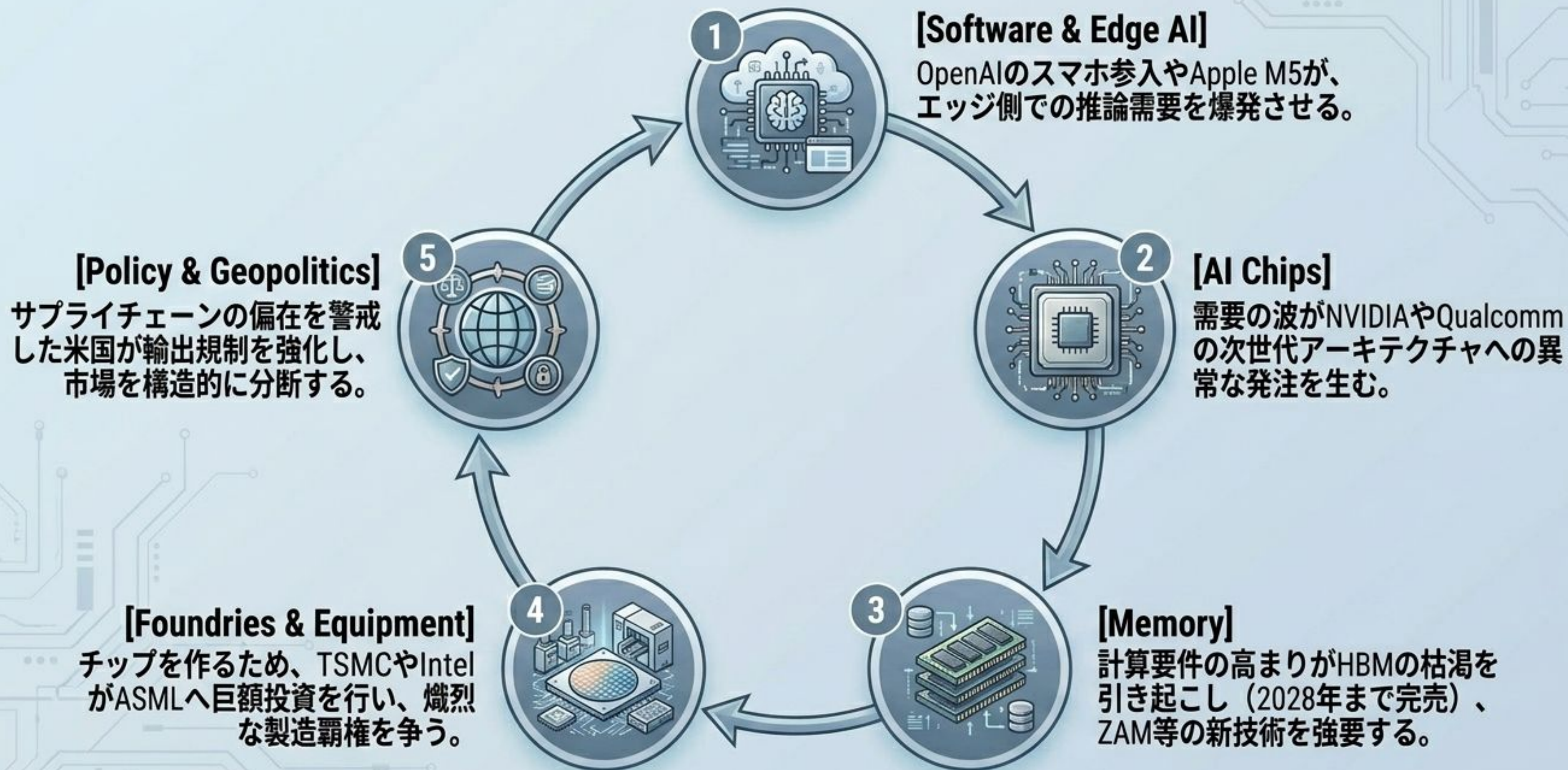
# The Capital Pipeline: AIインフラへ集中する巨額の再投資



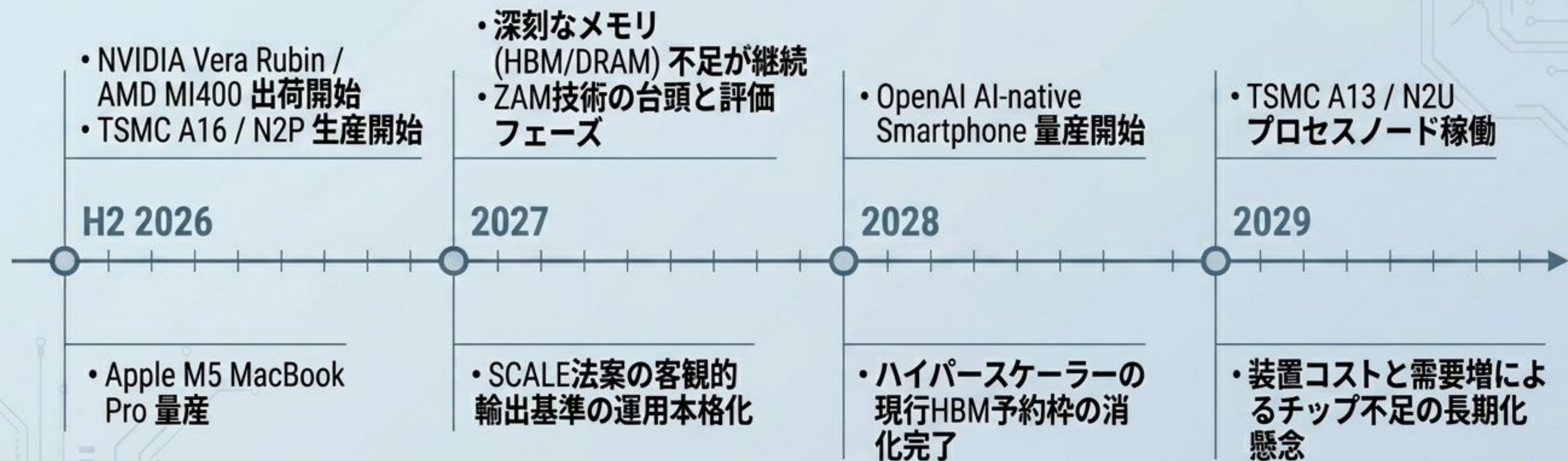
# The Geopolitical Wall: 強化される輸出管理という「フィルター」



# The 2026 Semi Feedback Loop: 全ては一つのシステムとして連動する



# Roadmap to 2029: 今週のニュースが示す数年先の未来



*The industry is not just scaling—it is structurally re-architecting.*

## SOURCES & METHODOLOGY

Where this week's stories came from

30+ articles screened across financial press, semiconductor trade press, corporate IR, and venture-data sources for the 7 days ending April 30, 2026.

Source	Articles	Coverage focus
CNBC	6	Financial / earnings / stock-impact reporting
Tom's Hardware	5	Chips, foundries, export controls
Bloomberg	2	Financial news; chip policy & macro
Yahoo Finance	2	Financial-news syndication (Korea Herald, Benzinga)
The Next Platform	1	Enterprise & HPC silicon analysis
DigiTimes	1	Asia-Pacific semiconductor supply chain
NVIDIA / ASML / SK hynix / Intel (IR)	4	Direct corporate filings & press
Crunchbase / AI Funding Tracker	2	Venture funding data & trends
TechCrunch / Tech Startups / Embedded Computing	3	Startup & semi-IP industry trade press
SemiWiki / 24-7 Wall St. / IndexBox / Wccfttech	4	Industry analysis & equity-markets commentary
Macworld / TechRadar / Tom's Guide / Ken Saunders	4	Consumer-chip product & benchmark coverage
House Select Committee on the CCP	1	U.S. legislative source on chip-export policy